

第103回レーザー加工学会講演会 予告プログラム

1日目 2025年12月22日(月) 大阪大学コンベンションセンター

会議室2			
9:20	開会の辞		
プレナリーセッション			座長：塚本 雅裕 (大阪大学)
9:30	LPBFチタン造形材の力学機能化に向けたロバスト合金設計		近藤 勝義 (大阪大学)
10:30	粉末を用いたDED方式金属積層技術の実用化に向けた課題とその解決		舟田 義則 (石川県工業試験場)
昼食休憩 (11:30-12:30)			
会議室2：ショートプレゼンテーション 会議室1：ポスタープレゼンテーション テーブルトップ展示 カタログ展示			
12:30～	ポスターショートプレゼンテーション(各2分間, ホール) + ポスタープレゼンテーション		座長：佐藤 雄二 (大阪大学)
	ポスター講演	テーブルトップ展示	カタログ展示
	AODを用いたプリント基板への穴あけ加工の高速化と高精度化の検討 手鹿 康弘 (伯東㈱)	(株) プロフィット	(株) ダイネット
	レーザー直接接合によるPEEK-CFRPとチタン合金の接合機構解明と特性評価 中村 強 (海洋研究開発機構)	(株) Civan Japan	レーザーライン(株)
	超短パルスレーザーを用いたガラス基板上への銅粒子焼結条件の検討 富田 起暢 (立命館大学)	ブネウム(株)	(株) レーザーシステム
	超短パルスレーザーを用いた白板ガラスとPMMAの接合条件の検討 中村 諒 (立命館大学)	夏目光学 (株)	
	超短パルスレーザーを用いたソーダガラスへのPTFE転写による濡れ性の変化 岡本 周 (立命館大学)	(株) インテック	
	高圧水素用高強度ステンレス鋼管に対するレーザー溶接の適用性の検証 田中 慶吾 (大阪産業技術研究所)	(株) ダイネット	
	金属と樹脂のレーザー接合における接合面の放射率と温度のインプロセス測定 杉田 侑輝 (名古屋工業大学)	レーザーライン(株)	
	超硬合金のレーザー肉盛における溶融池の温度制御 山口 拓人 (大阪産業技術研究所)	(株) レーザーシステム	
	高出力半導体レーザー用Cu-Diamond放熱基板 佐藤 秀明 (㈱アライドマテリアル)	旭化成 (株)	
	太陽光励起レーザーの高効率化に向けた太陽光キャビティの形状最適化の検討 山田 涼太 (東京工科大学)		
	フェムト秒レーザー加工による超薄板カンチレバー型センサーの応用 ヤリクンヤシャイラ (奈良先端科学技術大学院大学)		
	青色半導体レーザーマルチビームクラッディング法による窒化アルミニウムへの純銅皮膜形成技術の開発 徳本 潤平 (大阪大学)		
	Demonstration of Clean Adhesive Removal Utilizing Short Pulse CO ₂ La Ke Jiang (山梨大学)		
ポスターセッション&コーヒーブレイク 13:30～15:00			
会議室2		会議室3	
22A1	先進レーザー溶接 座長：岡崎 朋也 (トヨタ自動車)	22B1	レーザー微細加工 座長：古田 啓介 (三菱電機)
15:00	真空レーザー溶接技術の適用事例と現象解析 富田 海 (JFEスチール)	15:00	【特別講演】超短パルスGHzパーストモードプロセッシング 杉岡 幸次 (理化学研究所)
15:30	ビームモード制御技術を用いたファイバーレーザー溶接の自動車部品適用 阿津地 真也 (フタバ産業)	15:40	深紫外レーザーの開発と半導体検査・微細加工への応用 小池 康太 (オキサイド)
16:00	e-Mobility部品に貢献する銅のレーザー溶接について 神田 和輝 (デンソー)	16:10	超短パルスレーザーによる微細加工技術や事例 大竹 俊介 (リパス・ワークス)
16:30	【ベストオナー賞受賞】コールドスプレー皮膜を中間層として利用した高張力鋼とアルミニウム合金のレーザー接合 ― ポロシティ発生に影響を及ぼす因子の解明― 前田 恭兵 (神戸製鋼所)	16:40	【ベストオナー賞受賞】フェムト秒レーザー加工の学理解明に向けた集光プロファイルの精密計測およびシミュレーション手法の開発 小西 邦昭 (東京大学)
17:00	終了	17:10	終了
18:00～ 懇親会 (大阪大学 NSSOL Café)			

第103回レーザー加工学会講演会 予告プログラム

2日目 2025年12月23日(火) 大阪大学 コンベンションセンター

会議室2			会議室3		
23A1 レーザ粉末床溶融結合法 (PBF) 座長：佐藤 雄二 (大阪大学)			23B1 最新レーザー 座長：宇野 和行 (山梨大学) / 竹中 啓輔 (大阪大学)		
9:30	【特別講演】 AM用高機能金属粉末の研究開発	柳谷 彰彦 (兵庫県立大学)	9:30	【特別講演】 レーザ加工での応用を目指した新しい高耐力、超低挿入損失、デブリフリー気体光学素子の開発	米田 仁紀 (電機通信大学)
10:10	ハイブリッド金属3Dプリンタ "LUMEX " 活用事例	松原 英人 (松浦機械製作所)	10:10	レーザー加工用利得スイッチps/sub-psシードパルス光源の開発	小林 真隆 (東京大学)
10:40	レーザープロセスとDindriteの融合がもたらすPBFの革新的造形技術	木寺 正晃 (愛知産業)	10:40	Light Conversion社 フェムト秒レーザーとBiBurst加工応用例	寺岡 裕師 (フォトテクニカ)
11:10	LPBFの本質：データ駆動型製造技術としての再定義	酒井 仁史 (NTT データザムテクノロジーズ)	11:10	高品位加工に向けたパラメータ制御CO ₂ レーザーの開発	宇野 和行 (山梨大学)
昼食休憩 (11:40-12:40)					
会議室2			会議室3		
23A2 産業応用 座長：三瓶 和久 (タマリ工業)			23B2 バイオミメテクス 座長：中村 暁史 (パナソニック)		
12:40	建設現場におけるレーザー施工のリスクアセスメント	永井 香織 (日本大学)	12:40	【特別講演】バイオミメテクスとAIが導くレーザー機能表面設計の新展開	山口 昌樹 (信州大学)
13:10	電極乾燥工程で消費電力を半減するレーザー乾燥装置	外山 達志 (武蔵ワイヤード)	13:20	産業応用に向けたバイオミメテクス加工技術の展開	島田 秀寛 (RYODEN)
13:40	高出力Blue-IRハイブリッドレーザー用ガルバノスキャナの開発と応用	高橋 秀知 (タマリ工業/高知工科大学)	13:50	レーザー量子加工によるナノドット構造形成とバイオミメテクスへの挑戦	草場 光博 (大阪産業大学)
14:10	レーザー加工に関する国際標準化の最新情報とその動向	橋新 裕一 (オフィス橋新)	14:20	セミの翹からインスピレーションを得たNanoSpike®の多機能発現	伊藤 健 (関西大学)
コーヒーブレイク (14:40~15:10)			コーヒーブレイク (14:50~15:10)		
会議室2			会議室3		
23A3 レーザクラディング 座長：村田 隆行 (川崎重工) / 佐藤 雄二 (大阪大学)			23B3 次世代レーザー微細加工 座長：竹中 啓輔 (大阪大学)		
15:10	【特別講演】 幅広ビームLC工法の特徴と肉盛層形成に関する比較研究	後藤 光宏 (富士高周波工業)	15:10	【特別講演】DLIPによる表面機能化	奈良 拓治 (プロフィット)
15:50	青色半導体レーザーを用いた純銅抗菌コーティング技術の開発	吉田 環 (大阪大学)	15:40	フェムト秒レーザーによるSiへのプラズモニク近接場の誘起と微細加工への応用	飯田 悠斗 (東京農工大学)
16:20	レーザークラディングにおけるロバストなAI条件推奨と高密度WC粒子肉盛層の造形	福山 遼 (神奈川県立産業技術総合研究所)	16:10	ナノ秒パルスレーザーを用いた金属の表面改質と車載部品への適用	高橋 侑椰 (デンソー)
16:50	レーザークラディングにおける臨界Weber数に基づいたガス巻込み抑制指針	田中 慶吾 (大阪産業技術研究所)	16:40	レーザー加工CPS (cyber-physical system) を用いたレーザー溶接シミュレータの開発	藤原 和樹 (パナソニックホールディングス)
17:20	終了				

※ 時間、内容の一部変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。